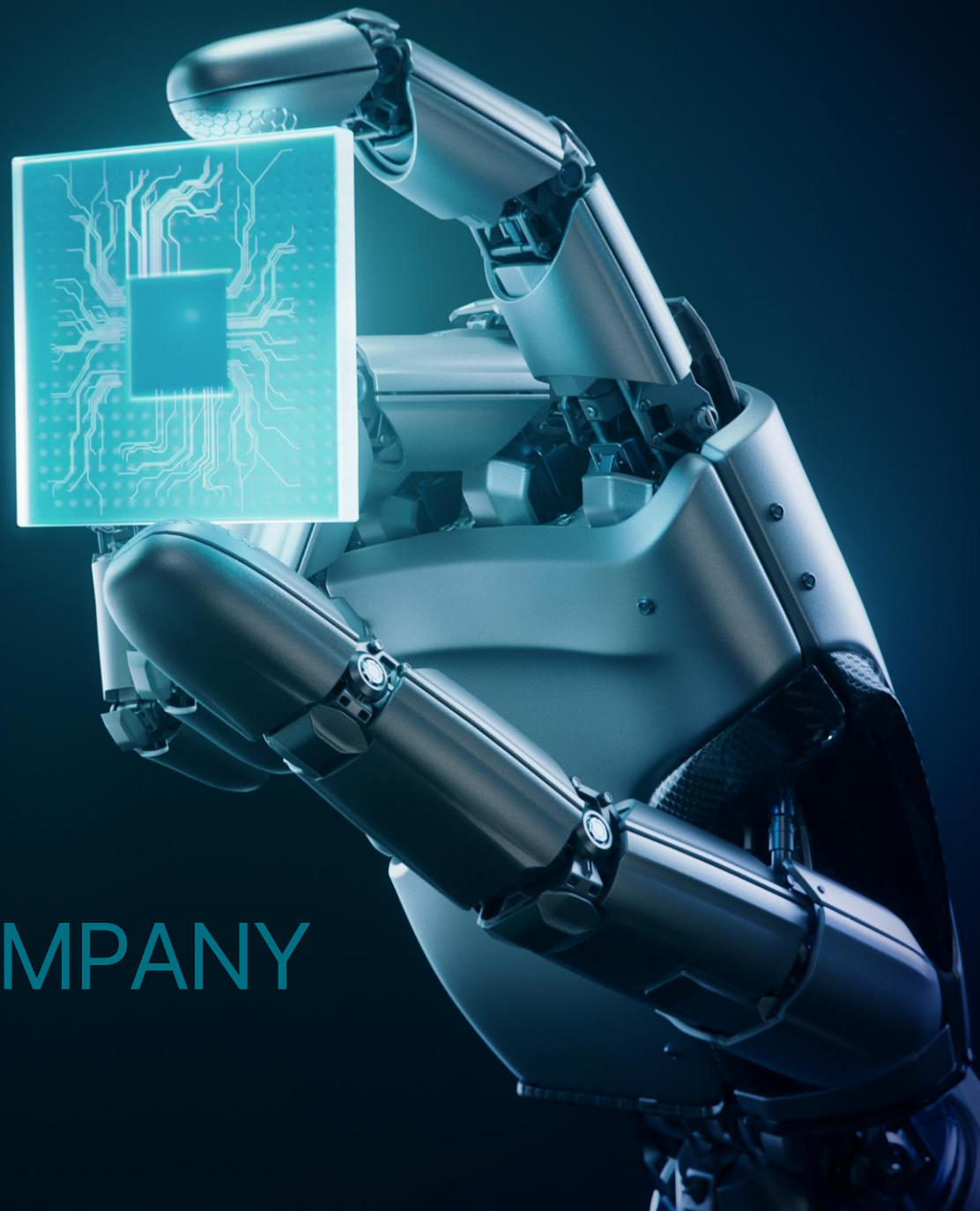
Chips&Media™



INVESTOR RELATIONS 2026

GLOBAL TOTAL MULTIMEDIA IP COMPANY **CHIPS&MEDIA**

DISCLAIMER

본 자료는 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 **칩스앤미디어**(이하 "회사")에 의해 작성되었습니다.

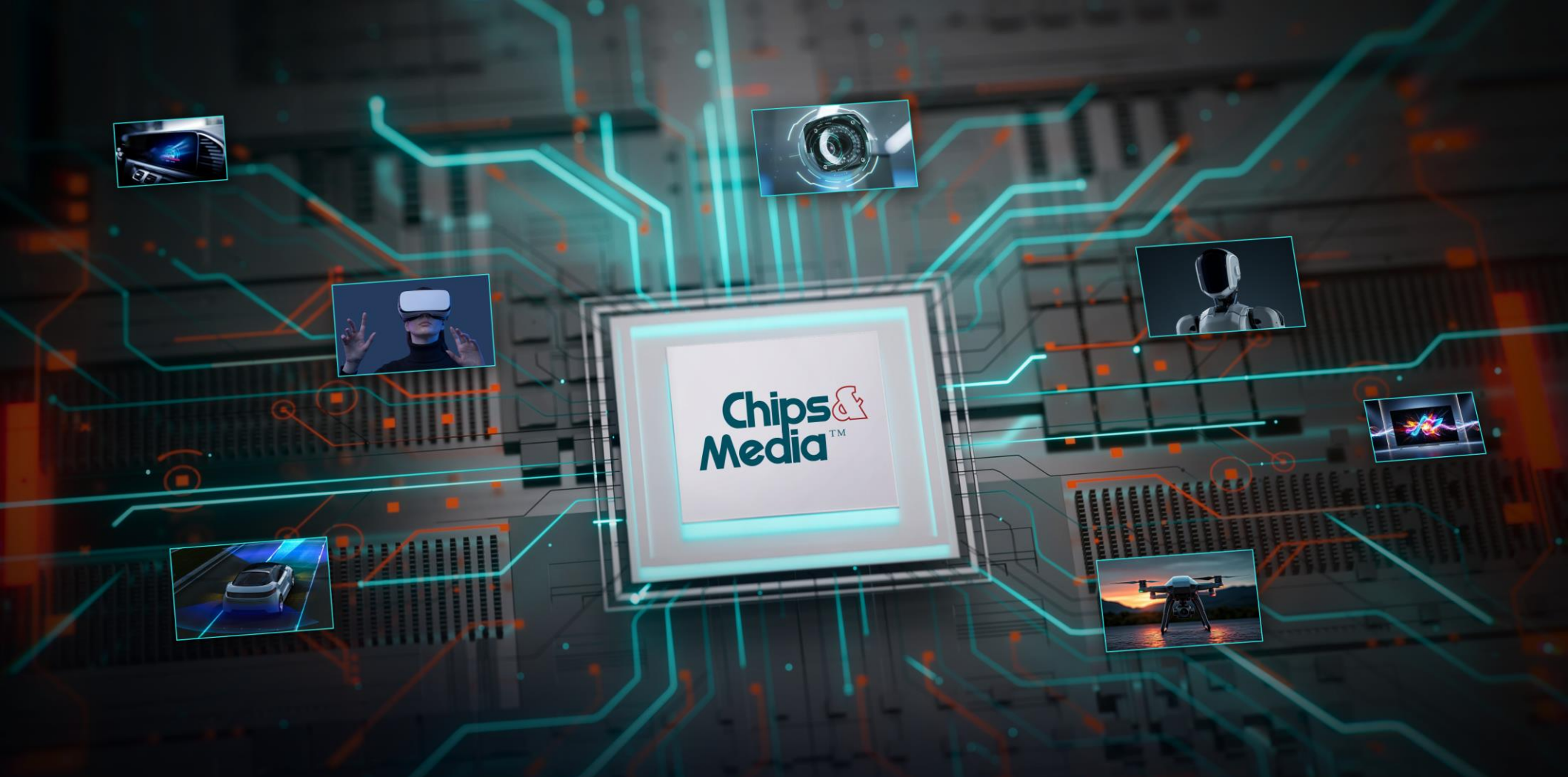
본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.



SEE THE WORLD WITH CHIPS&MEDIA

TABLE OF CONTENTS

01 PROLOGUE 02 COMPANY OVERVIEW 03 BUSINESS PERFORMANCE 04 GROWTH MOMENTUM 05 APPENDIX

01

PROLOGUE

1. AI 산업의 패러다임 변화
2. Physical AI의 핵심,
   'Eyes of Autonomous Machines'

Chips & Media™

생성형 AI를 넘어, 스스로 판단하고 움직이는 'Physical AI' 시대로의 전환

생성형 AI를 넘어, 스스로 판단하고 움직이는 'Physical AI' 시대로의 전환

"CES

CES 2026 : "피지컬 AI의 'ChatGPT 모먼트' 도래"

2026. 01. 06"

"산업통상부

'정부, K-온디바이스 AI 반도체 전략 발표 : NPU를 제2의 D램으로

2025. 09. 30"

"techradar

시각 지능 기술, 피지컬 AI 생태계의 핵심 인프라로 안착

2025. 10. 20"

글로벌 피지컬 AI 시장 성장 전망

2024 44 → '24~30 Cagr 31.7% → 2030 230

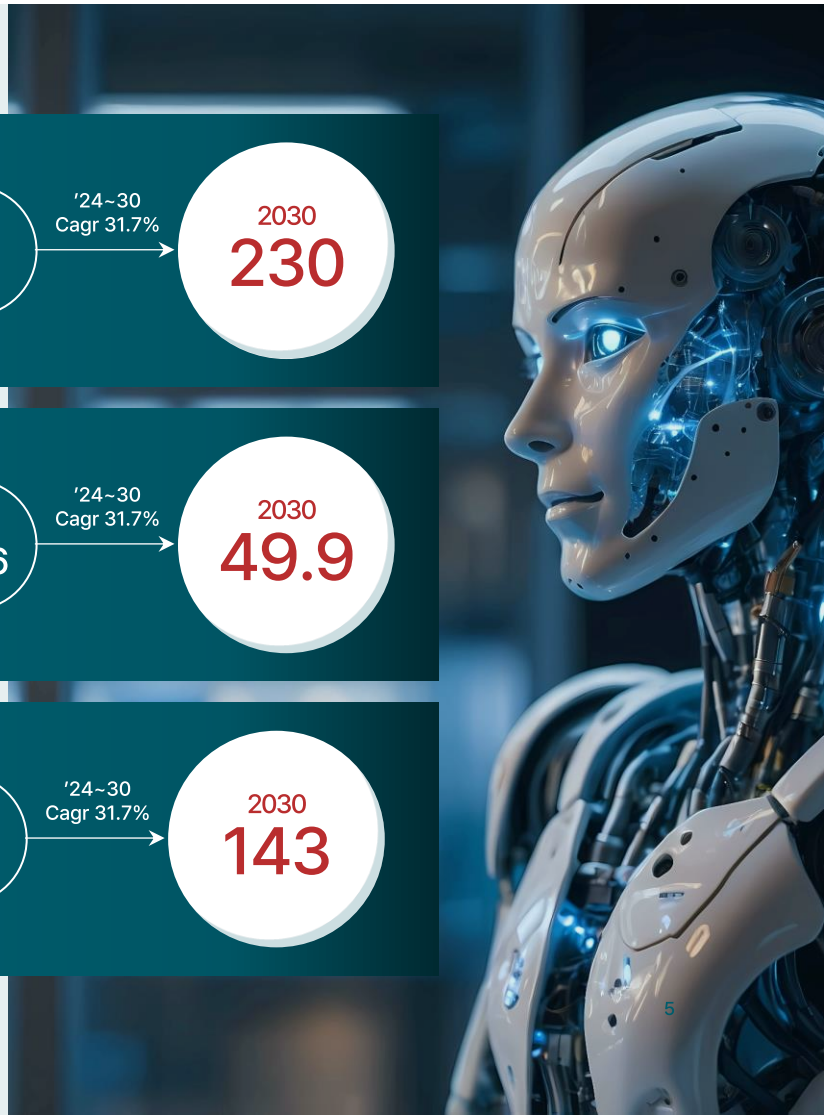
글로벌 로봇 비전 시장 성장 전망

2024 30.6 → '24~30 Cagr 31.7% → 2030 49.9

온디바이스 AI 반도체 시장 성장 전망

2024 25 → '24~30 Cagr 31.7% → 2030 143

자료 : Grand View Research, Statista, 카운터 포인트리서치 등 글로벌 시장조사기관의 2025-2026년 최신 보고서 인용
단위 : 억 달러



기록을 넘어 '인지'의 시대로, 멀티미디어 IP 수요의 폭발적 성장

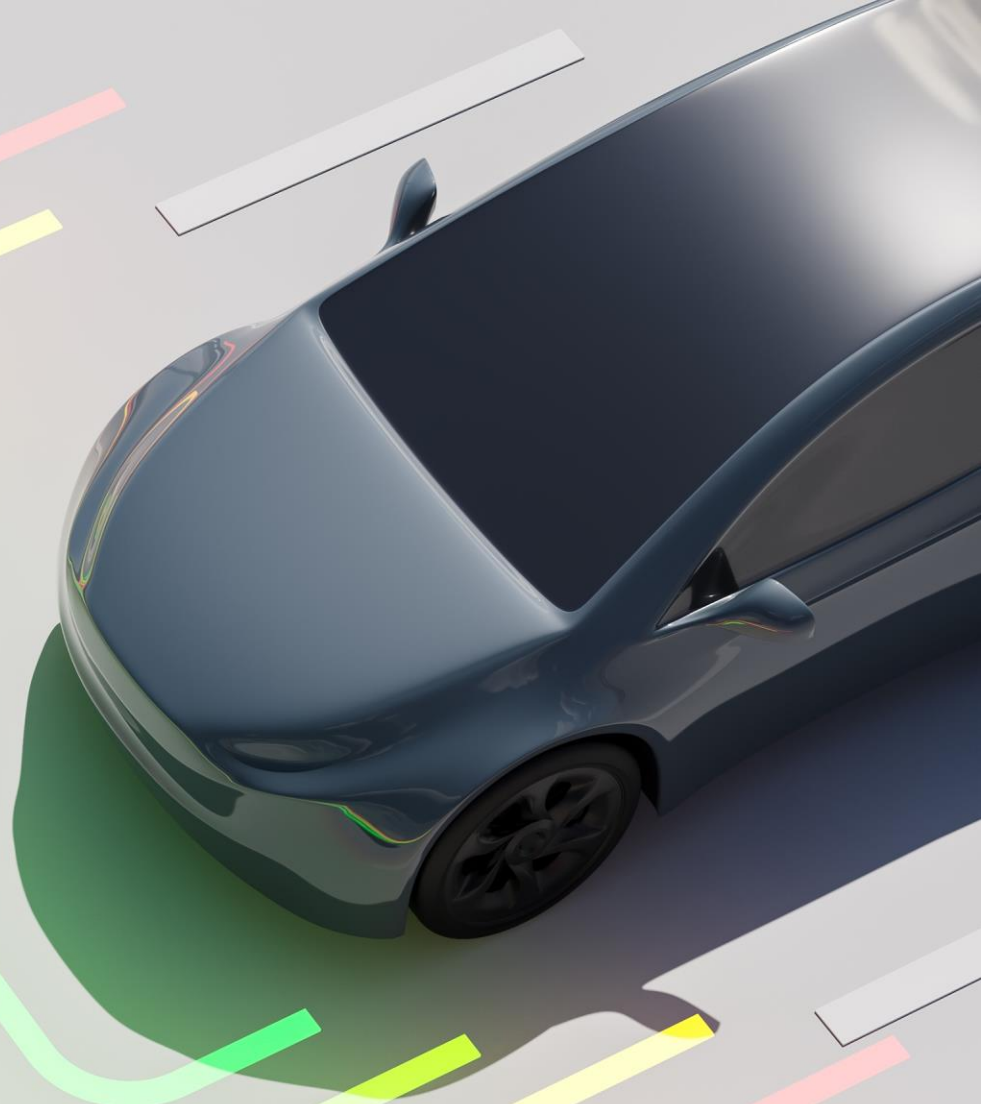
	휴머노이드	자율주행	UAM/드론	AMR (스마트팩토리)
카메라 적용수	8~12개	12~15개	4~8개	3~6개
주요 적용부	안면 인식 및 상호작용 공간 인지 (SLAM*) 및 경로 생성 정밀 작업용 핸드 비전 블랙박스	전면,측면,후면 카메라 ADAS eMirror 카 인포테인먼트	항법 제어 장치 항공용 영상 기록 장치 정밀 착륙 시스템	V-SLAM* 360도 카메라 사물 인지 비전 센서
시장 규모	CAGR 50.6% 4.9 (2025) → 165.1 (2034)	CAGR 19.9% 68.1 (2024) → 214.3 (2030)	CAGR 34.2% 5.0 (2024) → 29.2 (2030)	CAGR 14.4% 4.7 (2025) → 14.0 (2033)
	Fortune business insights	Grand view research	Grand view research	Grand view research

* SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)
* V-SLAM(Visual SLAM)

02

COMPANY OVERVIEW

1. No.1 Physical AI Pioneer
2. Corporate Hi-light
3. 사업 포트폴리오
4. 글로벌 고객 레퍼런스
5. 기술 경쟁력
6. 높은 진입장벽 추구
7. 경쟁사 현황



Chips & Media™

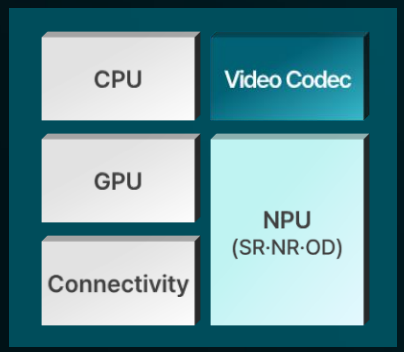
초고화질 영상 처리 및 인지 기반 4차 산업에 최적화된 솔루션

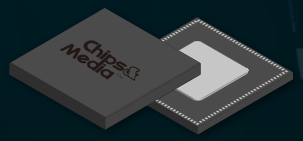
멀티미디어 IP란?

영상 데이터 처리에 필요한 반도체 설계자산으로 녹화, 재생 또는 영상분석을 위한 필수 솔루션

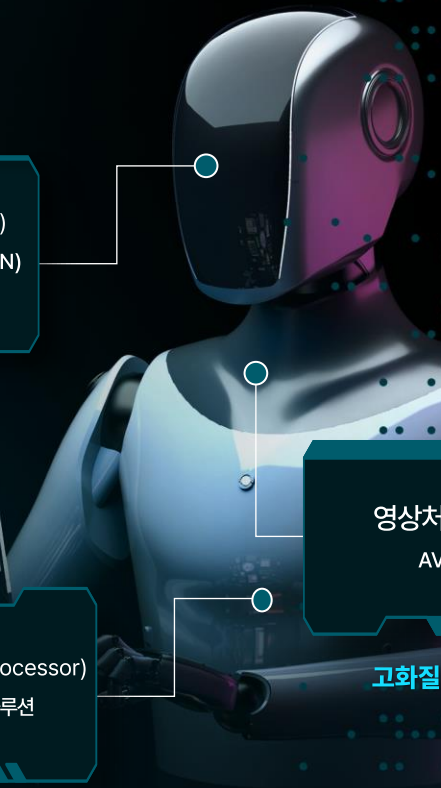
초고화질 비디오 처리 기술요구 및 4차산업에 연계된 영상분석을 위한 필수 솔루션으로 로봇, 자율주행차, 인공지능 데이터센터, 모바일, AR/VR, IoT 등 전방산업 확대

* IP (Intellectual Property) : 반도체 소자내에서 구현되기 위한 미리 정의된 논리회로 블록





Application Processor



AI 시각 지능 솔루션 (ISP&NPU)
실시간 보정 (ISP) 후 전용 NPU(WAVE-N) SR/NR/OD 알고리즘 기술 수행

화질 및 객체 검출 기능 상향

영상처리 (Video Codec)
AV1/AV2/APV 지원

고화질 영상 실시간 압축

데이터 처리 (Application Processor)
전체 시스템을 통합하는 AP 솔루션

모든 시각 지능 처리 및 제어

압도적 숫자로 증명하는 글로벌 스케일

Global No.1
멀티미디어 IP 전문 기업

Chips&Media™

등록 특허 · 상표권 83건
독보적 멀티미디어 IP 핵심 기술 보유

국내 35건
특허 등록 32건 / 상표권 등록 3건

해외 48건
특허 출원 42건 / 상표권 등록 6건

20억 +
25년 기준 자사 비디오 IP 누적 적용 칩 수
매년 100억 이상 로열티 수입

20년 +
20년 이상의
기술 축적 및
진입장벽 구축

24.5%
높은 영업이익률
(2025년 기준)

160개 +
Global Top Tier 포함 IP 라이선스 기업 수

Google, Qualcomm, Horizon Robotics, Texas Instruments, D-Robotics, Renesas, mobileye, rebellions_, Telechips, NXP

Physical AI를 관통하는 핵심 사업 포트폴리오 구축

Infra

서버 내 영상처리 수요 증가

- AI/GPU SoC
- Server
- Video Analysis

24%

Mobility

로봇, 자율주행, 카인포테인먼트 성장

- Robotics
- ADAS
- Drone
- Autonomous Driving SDV
- AVN/IVI

33%

Home Ent

OTT, VR, XR 등 새로운 영상 처리 기기

- AI PC
- STB/OTT
- DTV

18%

Camera

지능형 보안 및 영상 레저 시장 확대

- Sports Camera
- Surveillance
- Digital Camera

15%

Handset

핸드셋 카메라 화질 고도화

- Smartphone
- Smart watch
- Tablet

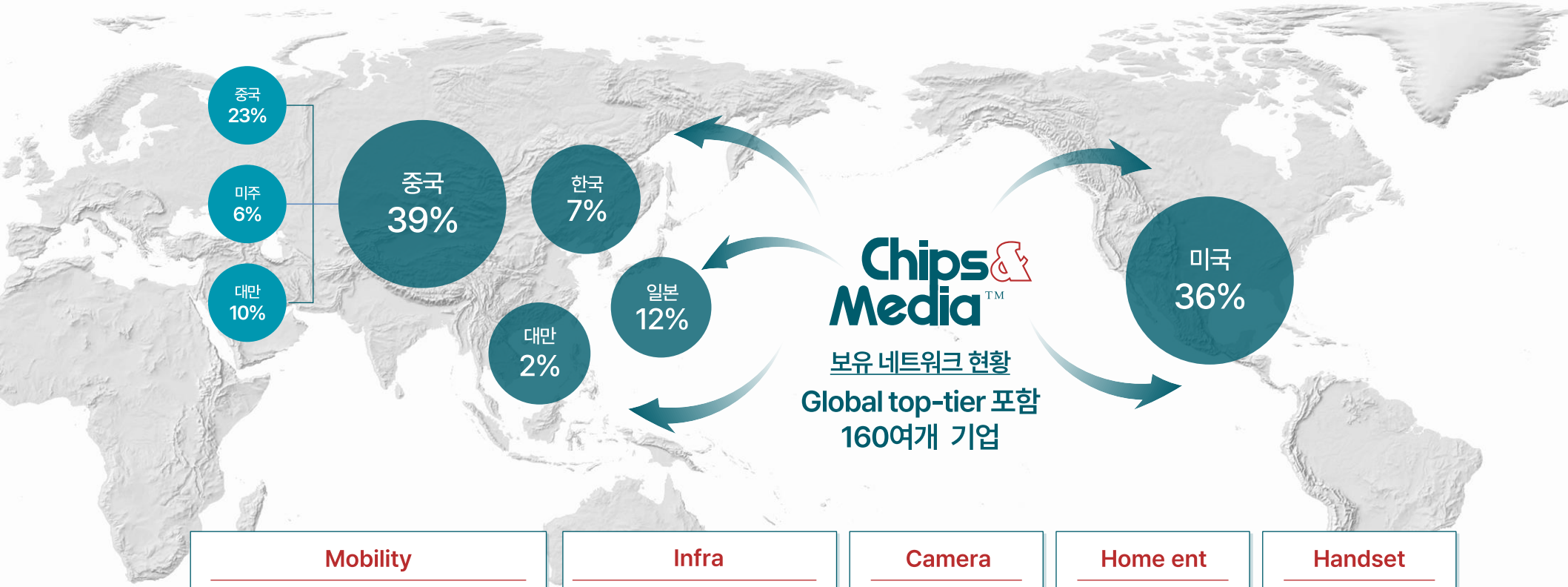
10%

Physical AI

통합 지능 솔루션

* 2025년 사업군별 매출비중

전 세계 160여 개 기업이 선택한 최상위 고객 네트워크



Mobility

NXP, Texas Instruments, Ambarella, Renesas, Mobileye, Horizon Robotics, Telechips, D-Robotics, SEMDRIVE

Infra

rebellions_mobilint, NETINT, China AI AoCs

Camera

Realtek, SigmaStar, socionext, Fullhan

Home ent

Qualcomm, SigmaStar, Amlogic

Handset

Google, NXP

PPBA* 기반 압도적 기술 경쟁력 확보

PPBA	Performance	Power	Bandwidth	Area
시장의 요구	고화질 데이터의 빠른 처리 속도	배터리 수명을 극대화 하는 초저전력 처리	DRAM 대역폭 절감을 위한 높은 압축 전송	비용 절감을 위한 작은 크기
기술의 현황	아이폰 17 Pro(4K 120fps) 갤럭시 S25(8K 30fps)	고화질 영상 구현시 전력 효율화 기술 중요성 증가	높은 대역폭 사용	비디오 표준 및 목적에 따른 IP 채택
Chips&Media™	최고 수준의 8K 60fps 지원	Extreme Low Power 1 MIPS 이하	효율적인 DRAM 접근 구조로 DRAM 사용량 최적화	멀티 스탠다드 지원 ALL IN ONE IP

AI의 눈과 신경망을 연결해주는 필수 인프라

* PPBA : 반도체 IP, SoC 경쟁력 평가 핵심 지표
Performance, Power, Bandwidth, Area

기술적 한계와 신뢰성이 만드는 강력한 해자

신규 경쟁사

신규 경쟁사

신규 경쟁사

나노 공정 고도화로 높은 기술난이도

10여개의 다양한 비디오 표준 별 개발 필요

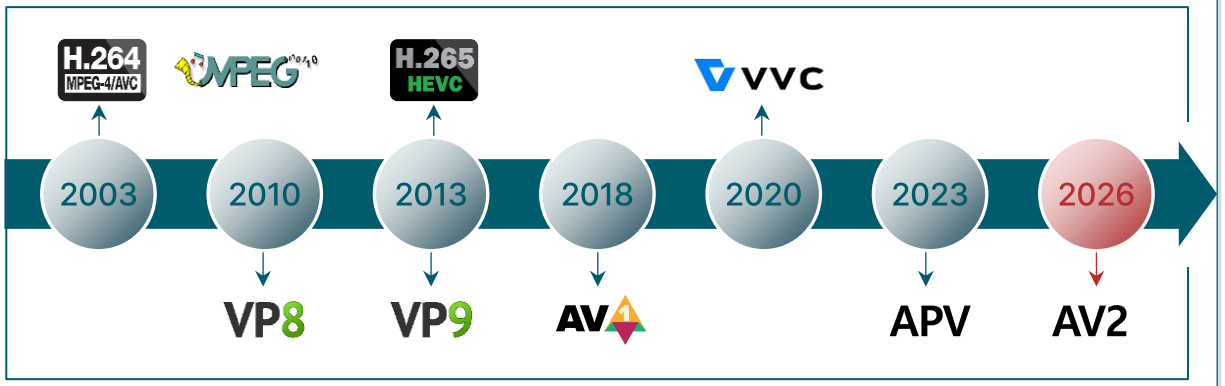
막대한 개발 비용으로 IP 신뢰성 중요

20여년간 멀티미디어 IP 기술 축적으로 160여개 기업에 IP 제공

"기술 우위 및 신뢰성 확보"

Performance	Power	Bandwidth	Area

비디오 표준 히스토리



모든 비디오 표준 처리 가능 ALL IN ONE 코덱을 구현,
현재 차세대 비디오 코덱 AV1, APV, AV2 개발 완료 및 상용화

글로벌 소수 과점 시장 내 독보적 포지셔닝

글로벌 No.1 멀티미디어 IP 기업

Chips&Media™

- 강력한 기술 경쟁력
- Video Codec에서 NPU IP, Compression IP 로 포트폴리오 확장
- 미중 무역 분쟁의 수혜
  - 미국, 일본에서 당사의 지정학적 경쟁 우위
  - 중국 자체 ecosystem 강화로 AI SoC 개발 수요 증가

소수 회사 과점 형태로 기술 제공 중

경쟁사

ALLEGRO Digital Video Technology

- 비디오 테스트 스트림 판매에서 2013 비디오 코덱 IP로 영역 확장

VeriSilicon

- ASIC Turnkey 서비스를 주력으로 Video 외 다양한 IP 확보
- Listed in China Star Market 시총 24조원 (2026.01)

安谋科技 arm CHINA

- ARM China 자체 NPU IP 등 독자적 기술 라인업 강화
- 중국 내 반도체 IP 시장 점유율 1위 및 독보적 생태계 구축

03

BUSINESS PERFORMANCE

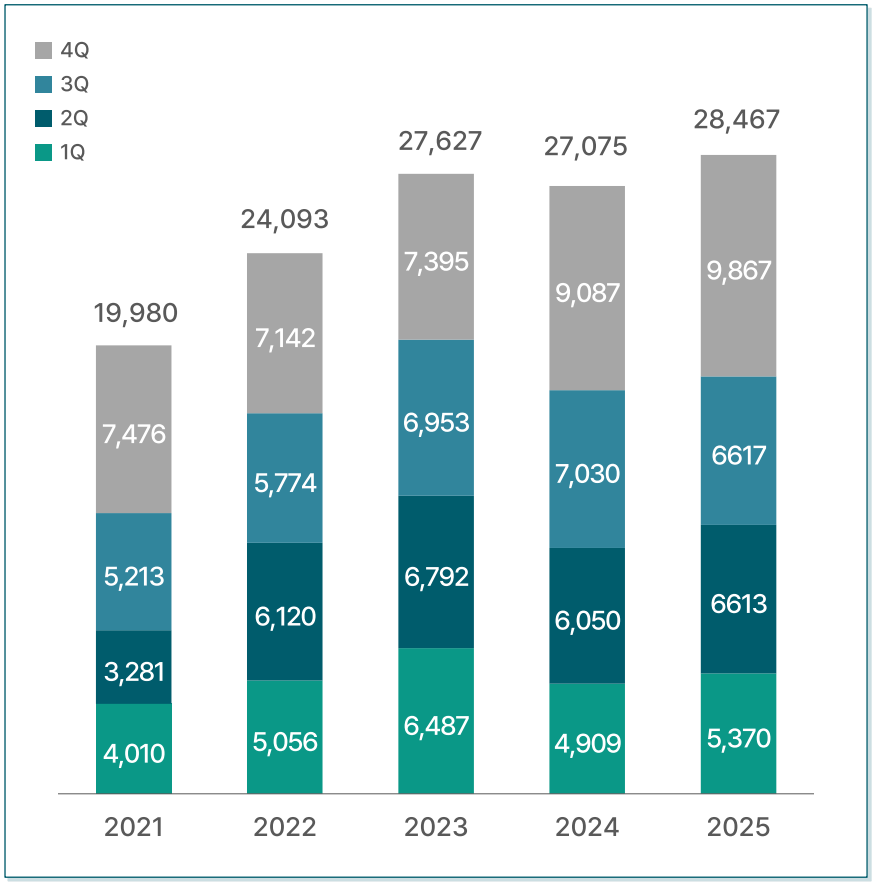
1. 경영 현황(실적)
2. 매출 현황 및 개요
3. 산업 및 국가별 분류
4. 라이선스 및 로열티 건수(연도별)

Chips & Media™

모바일 첫 로열티 발생, 자동차향 북미, 일본 신규 고객사 확보

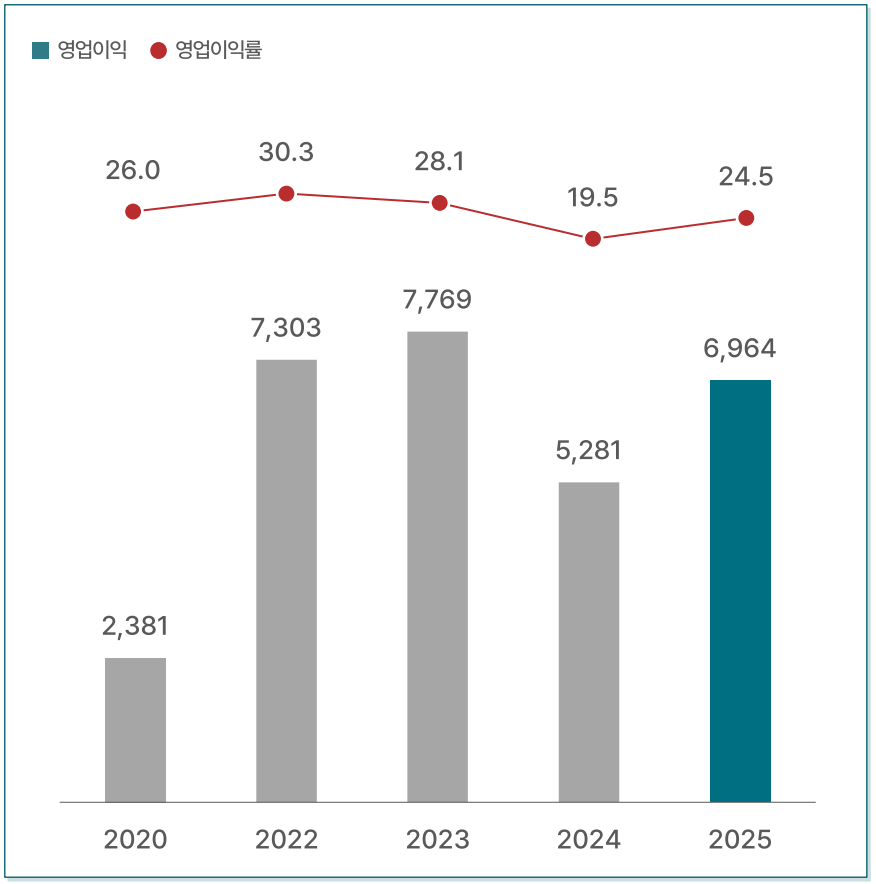
매출액

단위 : 백만 원



영업이익

단위: 백만 원, %



* 연결재무제표

전년동기비 매출액 8% 증가 AI SoC, Robotics향 신규 라이선스 발생

매출액

단위 : 백만 원

구분	분기별			연도별		
	2026.3Q	2025.3Q	YoY	2025 FY	2024 FY	YoY
매출액	7,162	6,617	8.2%	28,467	27,075	5.1%
라이선스	4,431	3,332	33.0%	17,065	15,193	12.3%
로열티	2,165	2,946	-26.5%	10,052	10,516	-4.4%
용역	565	339	66.8%	1,350	1,367	-1.3%
영업이익	1,657	1,525	8.7%	6,964	5,281	31.9%
당기순이익	-605	2,179	적자 전환	5,923	10,009	-40.8%

변동 주요 요인

- 국내 주요 팹리스 차량용 신규 프로젝트
- 국내 On-Device AI 반도체 사업 관련 첫 라이선스 발생
- 중국 AI SoC, 휴머노이드 Robot 향 신규 라이선스
- G사 모바일 신규 라이선스
- Memory 수급 영향으로 고객사 칩 생산 감소 → 로열티 감소
- 환차손, 금융자산 평가손실로 인한 당기순이익 감소

향후 주요 이슈 및 성장 전략

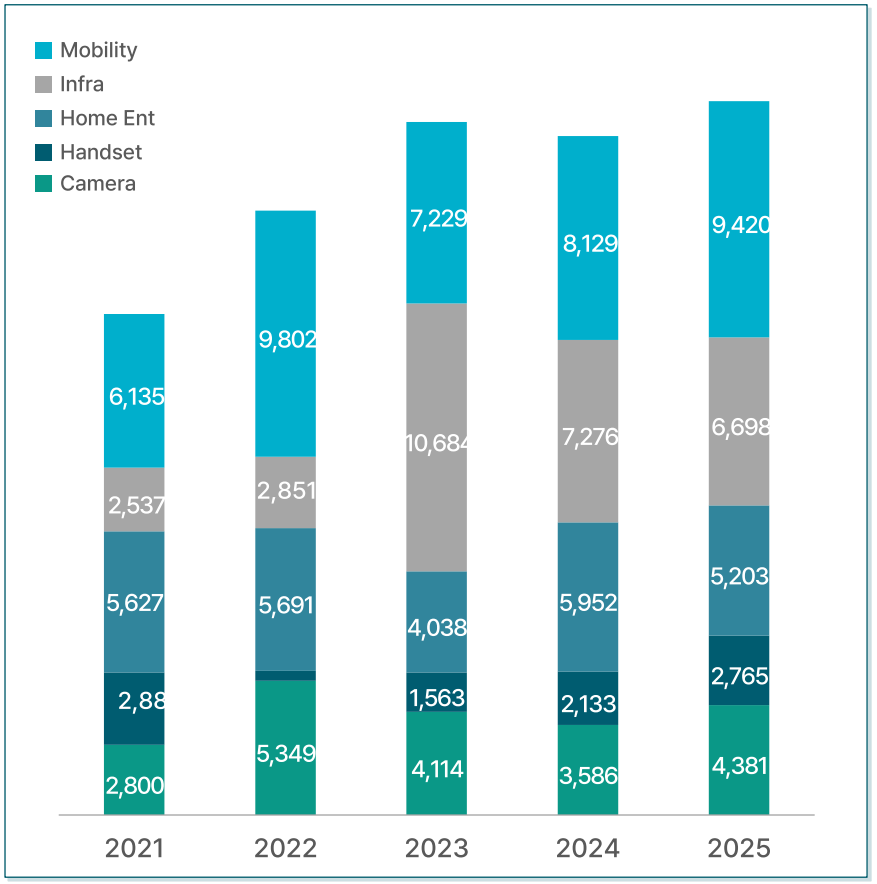
1. Mobility 시장 포지션 강화, 로봇, 드론, Edge AI 시장으로 고객 확대
2. AI ISP, NPU 및 Compression IP 기술을 기반으로 종합 Multimedia IP 기업으로 사업 포트폴리오 확대
3. AI 알고리즘 기업과의 협력을 기반으로 AI ISP 상용화
4. 글로벌 빅테크, 대형사 중심 영업 역량 강화로 고객 신규 유치
5. 중국, 제3차 반도체 기금 투입, IPO 활성화에 따른 펀딩 환경 개선, 경기 부양 및 반도체 공급망 강화에 따른 산업 회복 국면
6. 국내 On-device AI 반도체 투자 확대에 따른 반도체 IP 수요 증가

* 연결재무제표

포트폴리오 다변화를 통한 리스크 분산 및 성장성 확보

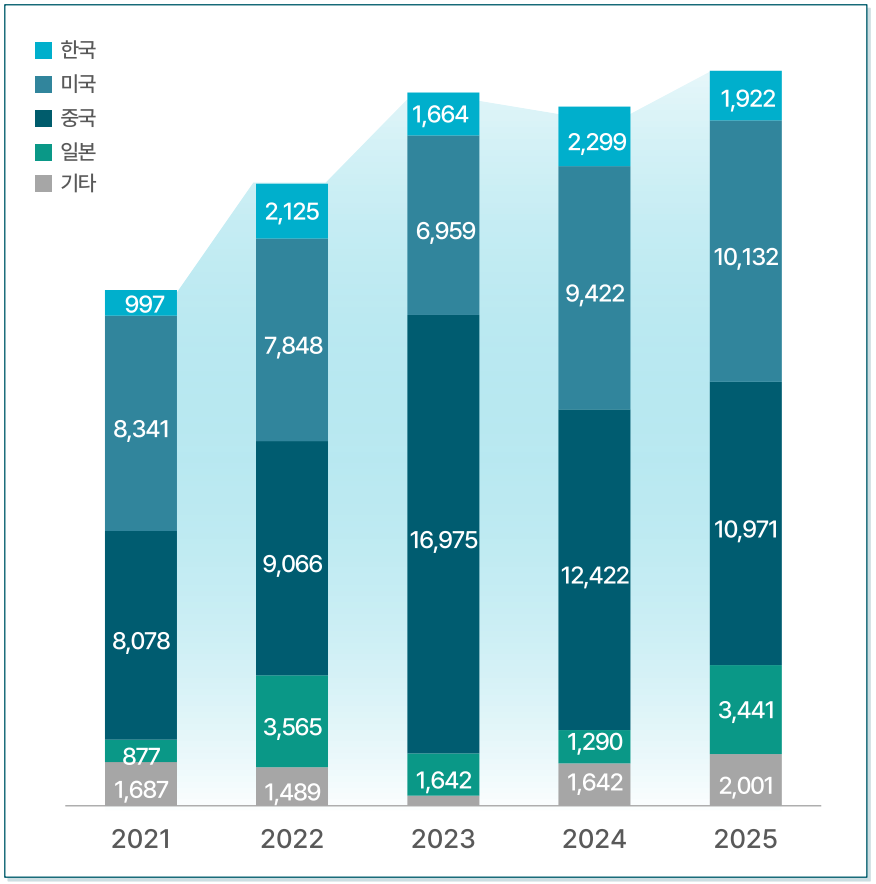
산업별 매출액

단위 : 백만 원



국가별 매출액

단위 : 백만 원

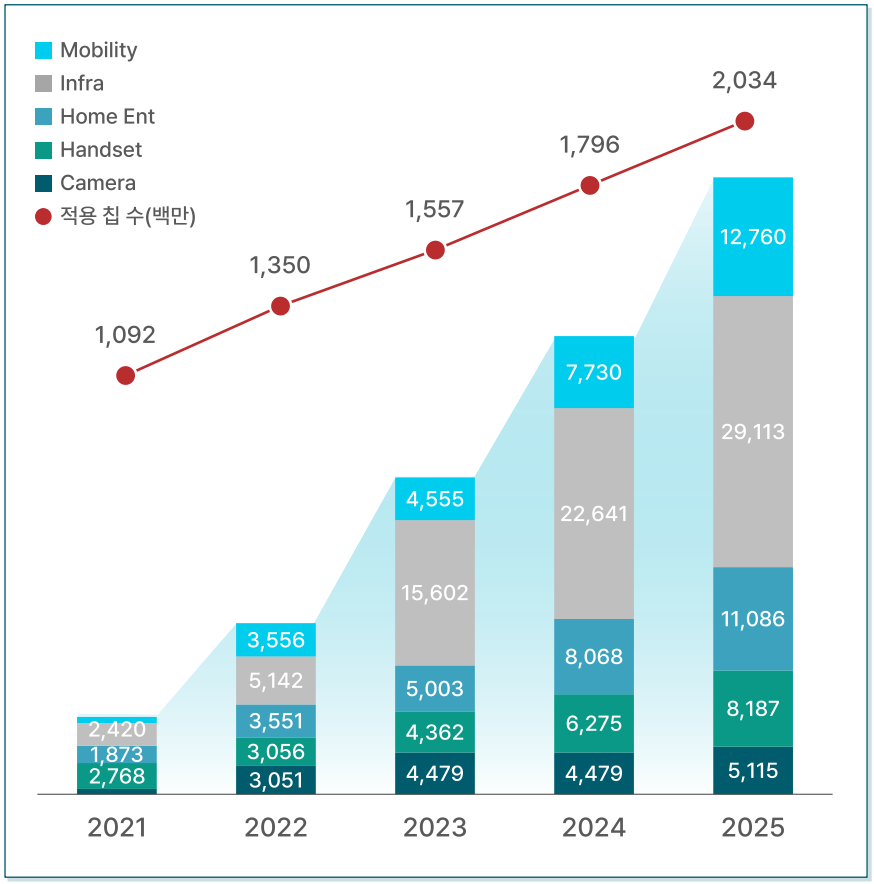


04. 라이선스 및 로열티 건수 (연도별)

라이선스 누적에 따른 지속적인 로열티 매출로 업계 최고 수준의 수익성 지속

5년간 누적 라이선스 및 적용 칩 수

단위 : 백만 원



선순환 비즈니스 모델

라이선스 → 제품화 → 로열티로 이어지는
선순환 수익 구조의 안정성 가시화

04

GROWTH MOMENTUM

1. C&M NPU IP 'WAVE-N'
2. 인공지능 영상처리
3. 메모리 최적화를 위한 Compression IP
4. 로봇 시장 본격 진출
5. 중국 반도체 자급화 및 정책 수혜를 통한 성장 가속
6. 글로벌 반도체 자급화에 따른 시장 확대
7. Vision

Chips & Media™

Chips&Media™

영상 처리에 특화된 세계 최고 수준의 원가 · 성능 경쟁력

NPU 도입 효과

NPU

(Neural Processing Unit)

인간처럼 생각하는 인공신경망 반도체

데이터센터 | 자율주행 | AR/VR | IoT

NPU 개발 배경

- 영상처리 Know-how
- 실시간 고화질 영상처리 수요 증가
- 인공지능 알고리즘 확보
- 데이터센터 내 영상 비중 80% 이상

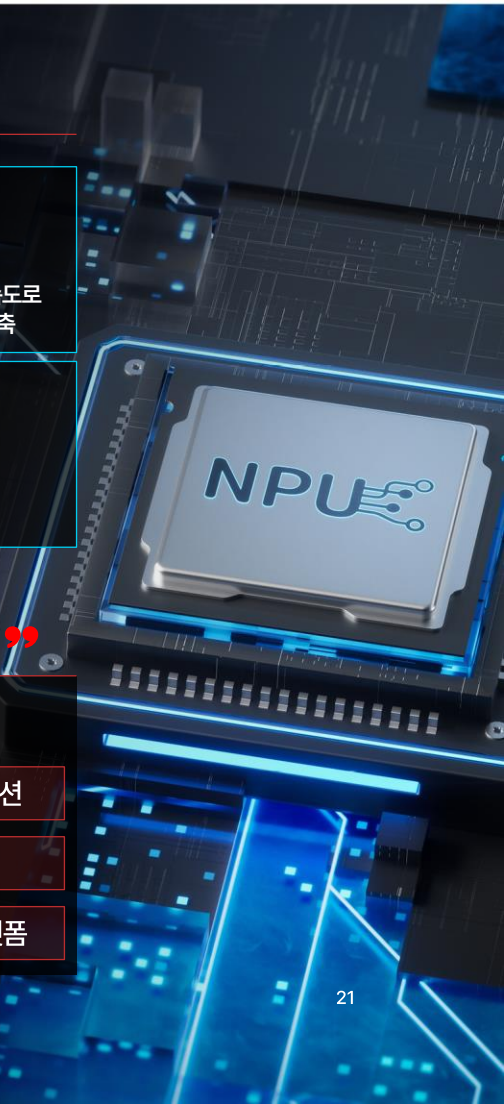
C&M NPU 'WAVE-N' 특징

- DRAM Bandwidth 최소화
- AI ISP 전용 설계
- 4~10배 빠른 속도로 개발 시간 단축
- Floating Point 방식의 AI 알고리즘 가변성 대응
- 영상처리 특화 NPU로 사이즈 최소화
- 높은 정확도

"영상처리 특화 AI 통합 솔루션"

칩스앤미디어 NPU 제품경쟁력

- 차세대 AI ISP : 핵심 영상 처리 (SR · NR · OD) 통합 솔루션
- 범용 NPU 대비 1/10 크기 구현 및 압도적 원가 경쟁력
- 글로벌 AI SW 협력 : 파트너사 최신 알고리즘 최적 구동 플랫폼



NPU를 활용한 인공지능 영상처리 알고리즘 기술

Super Resolution

딥러닝 기반의 알고리즘을 통해
높은 해상도로 변환하는 Scaler 기술

적용분야

영상처리, 의료영상, 안전 보안, 자율주행

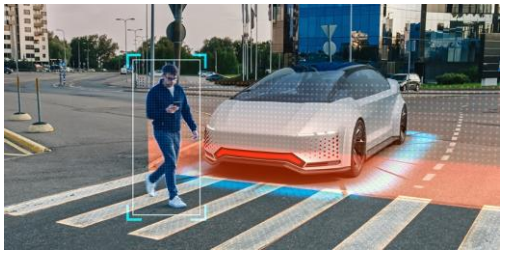
Noise Reduction

신호나 영상내 불필요한 노이즈를
제거하여 영상의 품질 향상

적용분야

디지털 카메라, CCTV, 모니터링, 의료영상

Object Detection



이미지나 비디오에서 객체를 자동으로
인식하여, 위치와 크기를 파악하는 기술

적용분야

자율주행, 보안감시, 로봇, 산업 자동화

AI 시대 메모리 병목 해소, C&M FBC 기술 경쟁력

CFrame60

CFrame60
(Frame Buffer Compression)

고화질 영상
처리의 핵심 IP

자동차 | 모바일 | 디지털 카메라 | 보안

신규 폼팩터 기반 라이선스 기회 창출

- **AI 시대 고화질 데이터 폭증**
  4K/8K + AI 처리로 데이터량 기하급수적 증가
- **메모리 대역폭 병목 심화**
  ISP · NPU · GPU 간 데이터 이동이 시스템 성능 제한
- **전력 소모 급증**
  메모리 접근이 많을수록 배터리 소모 증가

C&M FBC의 특징 및 경쟁력

- 저지연 처리
  (1~2라인 수준의 매우 낮은 Latency)
- 무손실 / 손실 압축 지원
  (손실 압축 시 1/2 ~ 1/4 수준)
- 화질 유지 및 데이터 크기 감소
- 메모리 효율을 위한 압축 기술
- DRAM 사용/ 대역폭 감소

C&M FBC의 역할

- 데이터 압축으로 메모리 트래픽 감소
- AI / 영상 처리 성능 유지 또는 향상
- SoC 내부 데이터 흐름 최적화
- 전력 효율 개선 (DRAM 접근 최소화)

메모리 병목 해소 기술력 기반 AI 엣지 최적화, 칩스앤미디어 차세대 성장 동력 확보

글로벌 Physical AI 시각 지능 시장 주도

매출규모

🇺🇸	Texas Instruments, Ambarella, Mobileye, NXP
🇨🇳	Horizon Robotics, SEMDRIVE
🇰🇷	Telechips, nextchip, eyenix
🇯🇵	RENESAS

글로벌 자동차 반도체 시장 내
높은 C&M IP 침투력

로봇시장
진출

기존 사업 고도화 및 기반 구축

AS-IS

Physical AI
본격화

To-Be

Physical AI 신시장 진출

매출확대 기반 구축

Physical AI 시장 지배력 확보

- 로봇 생태계 선점
- 통합 솔루션 공급
- Physical AI 시장 주도

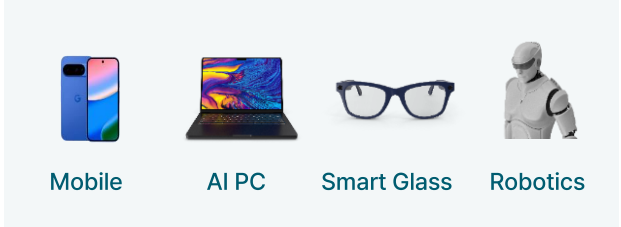
- 북미 빅테크 공략
- 신규 폼팩터 창출
- 글로벌 정책 수혜

북미 전략 거점 강화를 통한 글로벌 IP 라이선스 확대

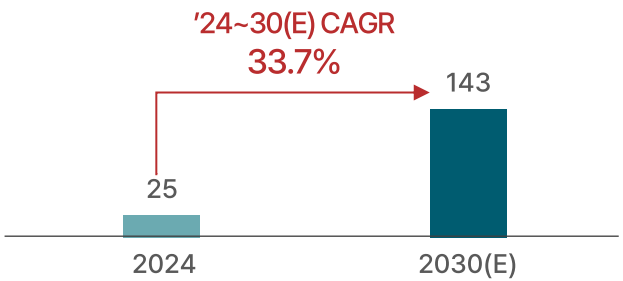
북미 IP 생태계 장악 위한 전략 거점 강화

신규 폼팩터 기반 라이선스 기회 창출

AI 시대 핵심 디바이스



온디바이스 AI 시장 규모



연평균 33.7% 성장하는 온디바이스 AI 시장 내
독보적 IP 경쟁력으로 Multiple 재평가 견인

중국 반도체 자급화 및 시장 회복에 따른 비즈니스 기회 선점

중국 반도체 자립을 위한 자금 투입 가속화

중국 반도체 자급화 정책(1~3차)

제 1차 국가집적회로산업투자펀드 (2014년)
약 1,387억 위안 규모 제조 및 인프라 구축 중심

제 2차 국가집적회로산업투자펀드 (2019년)
약 2,000억 위안 규모 설계 및 소재 · 부품 · 장비(소부장) 국산화 중심

제 3차 국가집적회로산업투자펀드 (2024년 5월)
약 3,440억 위안(한화 약 64조 원) 역대 최대 규모 집행
AI 반도체 및 첨단 패키징 집중 투자

중국 내 IPO 활성화

상장 진입장벽 완화를 통한 민간 자금 유입 확대로
연내 약 400개 반도체 기업 상장 추진

칩 설계 기업들의 Funding 접근성 향상, 자금 조달 환경 개선
→ 투자 확대에 따른 IP 라이선스 수요 증가

중국 내 현지 영업 경쟁력 극대화

Joint Venture 개요

법인명	InnoChipsMedia (ICM)
설립일	2024년 9월 중국 현지 설립
주요사업	디자인솔루션파트너, IP 재판매

중국 시장 수익성 극대화 및 지배력 확보

중국 시장 내 자체 IP 재판매	데이터센터용 특화 IP 추가 개발로 중국 시장 직접 공략
중국 내 영업 경쟁력 강화	JV향 반도체 설계 라이선스 매출 극대화

중국 시장 공략 가속

3차 반도체 펀드 집행
역대 최대 3,440억 위안 규모

반도체 자급화 가속
중국 내 팹리스 고객사 증가 및 라이선스 수요 확대

중국 반도체 자립 정책 확대에 선제 대응한 JV 전략으로 중국 시장 지배력 강화

글로벌 반도체 자급화 가속, 신흥 시장 IP 수요 폭증

글로벌 반도체 자급화 배경

- 러 · 우 전쟁
- 미·중 갈등
- 중동 전쟁
- COVID-19

지정학적 리스크 확산으로
글로벌 반도체 공급망 불안정 가속

다극화된 글로벌 수요 구조

유럽
EU Chips Act 통한
선진국 경쟁 참여 본격화

중동
데이터센터 · AI 인프라
투자 확대 가속

동남아
생산기지 + IT 제조 허브
성장으로 설계 수요 증가

인도
정부 주도 반도체 육성
및 내수 시장 확대

글로벌 자급화 물결 속 신흥 시장
IP 라이선스 신규 기회 급부상

각국의 반도체 자급화 정책 강화

반도체 자급화 가속으로 제3국 설계 · IP 수요 확대,
칩스앤미디어 수혜 본격화

Physical AI 시대의 글로벌 멀티미디어 IP 리더로 도약

중국 반도체 자급화 및 시장 회복 수혜

중국 IPO 활성화 및 3차 반도체 펀드 집행

로봇 시장 본격 진출

중국 주요 로봇 AI칩 · 플랫폼 기업
라이선스 확보

Chips & Media™

북미 빅테크 공략 가속화

글로벌 빅테크 출신 Sales 리더십 확보
미국 영업 네트워크 확장

Physical AI
Core Engine

As-Is

No.1 Physical AI Pioneer	ALL-IN-ONE 솔루션	Global Top-tier 파트너십	압도적 양산 레퍼런스
글로벌 멀티미디어 IP 리더	표준 통합 및 크기 최소화	글로벌 빅테크 대상 라이선스 확보	칩 설계부터 양산까지 검증된 기술력

05

APPENDIX

1. 회사개요
2. 성장 히스토리
3. 재무제표

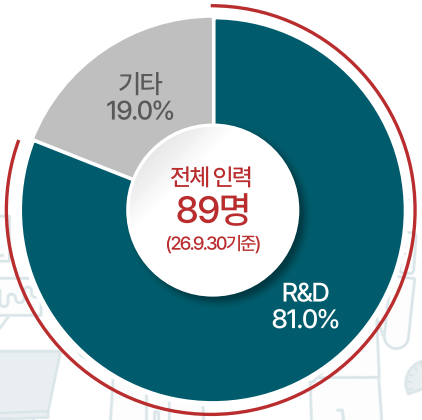
Chips & Media™

20년 + 업력의 글로벌 멀티미디어 IP 기술 선도 기업

기업개요

회사명	(주)칩스앤미디어
대표이사	김상현
설립일	2003. 03. 06
자본금	108억 원
임직원수	89명(2026.9.30 기준)
주요사업	비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업
본사주소	서울시 강남구 테헤란로509 7층, 8층
홈페이지	www.chipsnmedia.com

R&D 인력 현황



전체 인력 중
R&D 인력 비중
72명

대표이사소개

이 호 부 사장	CFO	· 서울대 경제학과 · 삼성물산(주) 재경팀 · 칩스앤미디어(2004~현재)
강 원 모 상무	CHRO	· 중앙대 경영학과 석사 · BOE 하이디스 · 칩스앤미디어(2007~현재)
권 중 현 이사	CTO	· 서울대 컴퓨터공학과 석사 · GCT Semiconductor · 칩스앤미디어(2003~현재)
최 주 환 이사	CSO	· 서울대 중어중문학과 · 오픈엣지테크놀로지(2018~2024) · 칩스앤미디어(2005~2017, 2025~현재)

글로벌 멀티미디어 IP 리더로 성장

2003년 ~ 2006년

회사 설립 및 반도체 IP 제품화

창 립 기

- '03.03 회사 설립
- '03.05 기업부설연구소 인증
- '04.09 국내 첫 비디오 IP 라이선스
- '04.10 벤처캐피탈 투자 50억원 유치
- '05.10 해외 첫 비디오 IP 라이선스
- '06.07 최초 로열티 수익 발생

2007년 ~ 2014년

고해상도 비디오 IP 개발을 통한 시장선도

성 장 기

- '07.12 FULL HD급 멀티 표준 비디오 디코더 IP 출시
- '08.04 칩스앤미디어와 씨앤엠마이크로 인적 분할
- '08.05 대표이사 김상현 취임
- '09.04 최대주주 변경 (텔레칩스)
- '13.10 한국거래소 코넥스 시장 상장
- '14.04 UHD급 비디오 코덱 IP 출시

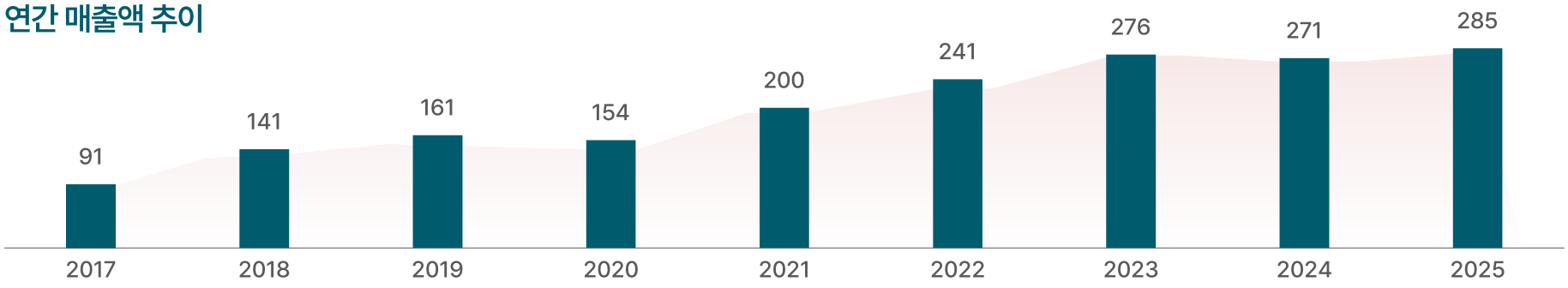
2015 ~ 현재

멀티미디어 IP 시장의 Leader

도 약 기

- '15.08 한국거래소 코스닥 시장 이전 상장
- '18.05 Computer Vision IP 출시
- '19.02 8K UHD급 비디오 코덱 IP 출시
- '19.10 세계 최초 커머셜 AV1 IP 출시
- '20.04 딥러닝 기반 Super Resolution IP 출시
- '21.06 Multi-standard 기반의 AV1 IP 출시
- '21.10 기술적용 반도체 칩 10억 개 돌파
- '22.07 최대주주 변경(한국투자파트너스)
- '23.09 NPU IP 출시
- '24.09 중국 JV 설립
- '26.01 세계 최초 AI ISP 출시

연간 매출액 추이



재무상태표

단위 : 백만 원

구분	2023	2024	2025
유동자산	56,323	51,901	74,129
비유동자산	24,334	32,079	32,175
자산총계	80,657	83,980	106,304
유동부채	5,505	4,961	7,246
비유동부채	2,206	3,237	14,550
부채총계	7,711	8,198	21,796
자본금	10,555	10,555	10,783
자본잉여금	60,385	23,035	29,027
기타자본항목	(69)	(11,586)	(13,024)
기타포괄손익누계	77	18	52
이익잉여금	1,998	53,760	57,670
자본총계	72,947	75,783	84,508

* 사업보고서(연결기준)

손익계산서

단위 : 백만 원

구분	2023	2024	2025
매출액	27,627	27,075	28,467
판매비와관리비	19,858	21,794	21,503
영업이익	7,769	5,281	6,964
기타수익	420	1,351	498
기타비용	646	240	682
금융수익	2,902	2,525	2,577
금융비용	38,962	42	169
관계기업투자손익	-	-	(3,183)
법인세비용차감전순이익	(28,516)	8,874	5,570
법인세비용	(1,818)	(1,135)	(353)
당기순이익	(26,698)	10,009	5,923